

半導体デバイス製造において、今やなくてはならないキーププロセスの全貌
 研磨精度・デバイス表面平坦度の向上とスラリー・パッド等部材の低コスト化の両立を目指して



CMP技術およびその最適なプロセスを実現するための総合知識 ~装置、スラリー・研磨パッド等の消耗材料の技術、 応用プロセス、研磨メカニズム~

- CMPの基礎知識、メカニズム■
- スラリー技術、パッド技術とその材料・開発・プロセス評価■
- デバイス応用事例、様々な基板研磨技術■
- CMP材料除去メカニズムの変遷と最新モデル■



日時	2019年5月30日(木) 10:30~16:30	会場	東京・千代田区駿河台 連合会館 4F 404会議室
受講料	48,600円 ⇒S&T会員 46,170円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 (定価:本体45,000円+税3,600円 会員:本体42,750円+税3,420円)		資料・昼食付

講師 (株)ISTL 代表取締役社長 博士(工学) 磯部 晶 氏

趣 旨

CMPがデバイスの製造工程に用いられるようになって、すでに四半世紀が経過した。当初はゲテモノ扱いされていたCMPも今やなくてはならないキーププロセスとなっている。
 半導体デバイス製造における様々なCMP工程の特徴を紹介し、それに用いられる装置、スラリー、パッドの詳細を解説する。さらに、CMPによる材料除去のメカニズムについて様々なモデルを紹介し、そこからパッドやスラリーの開発のヒントを提示する。

プログラム

- | | |
|---|---|
| <p>1. CMP装置</p> <p>1.1 CMP装置の構成 1.2 ヘッド構造</p> <p>1.3 終点検出技術 1.4 APC</p> <p>1.5 洗浄</p> <p>2. CMPによる平坦化</p> <p>2.1 CMPによる平坦化工程の分類 2.2 平坦化メカニズム</p> <p>3. CMP消耗材料</p> <p>3.1 各種スラリーの基礎 3.2 砥粒の変遷</p> <p>3.3 添加剤の役割 3.4 スラリーの評価方法</p> <p>3.5 研磨パッドの基礎 3.6 研磨パッドの評価方法</p> <p>3.7 コンディショナーの役割</p> | <p>4. CMPの応用</p> <p>4.1 最新配線構造とCMPの詳細</p> <p>4.2 最新のトランジスタ構造とCMP</p> <p>4.3 3DNANDにおけるCMP</p> <p>4.4 ウエハ接合技術とCMP 4.5 各種基板CMP</p> <p>5. CMPの材料除去メカニズム</p> <p>5.1 研磨メカニズムモデルの歴史</p> <p>5.2 新しいモデル~Ferret径モデル</p> <p>5.3 Ferret径モデルの数値検証</p> <p>5.4 Ferret径モデルに基づく開発のヒント</p> <p>5.5 パッド表面状態のマクロモデルによるドレス効果の表現</p> |
|---|---|

まとめ

□質疑応答□

■2名同時申込みで1名分無料■
 (1名あたり定価半額の24,300円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
 ※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
 ※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
 ※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
 ※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B190560 (CMP) P

会社名 団体名			
部署			
役職	〒		
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
 ※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み <input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み <input type="checkbox"/> 希望しない	S&T会員価格を 適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日) <input type="checkbox"/> 当日現金払い	
通信欄	

●受講料について
 「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
 ●お申込みについて
 申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
 また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
 お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
 ●お支払いについて
 受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、
 もしくは当日現金にてお支払いください。
 銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
 振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
 ご記入いただいた個人情報は、
 事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
 詳しくはホームページをご覧ください。
 ●キャンセル規定
 開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
 ・開催7日前以前でのキャンセル: キャンセル料はいただきません。
 ・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
 ・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
 ※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、
 事情により中止になる場合がございます。

サイエンス & テクノロジー
 研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
 サイエンス&テクノロジー株式会社
 TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
 〒105-0013
 東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
<http://www.science-t.com>